

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Februar 2007 (15.02.2007)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2007/017404 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:
Nicht klassifiziert

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2006/064787

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. Juli 2006 (28.07.2006)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2005 037 869.2 10. August 2005 (10.08.2005) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIEMENS AKTIENGESellschaft** [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **KASPAR, Michael**
[DE/DE]; Sonnenweg 4, 85640 Putzbrunn (DE).
SCHWARZBAUER, Herbert [DE/DE]; Kössener
Str. 13 A, 81373 München (DE). **WEIDNER, Karl**
[DE/DE]; Zäuserweg 6, 81245 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGESellschaft**;
Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

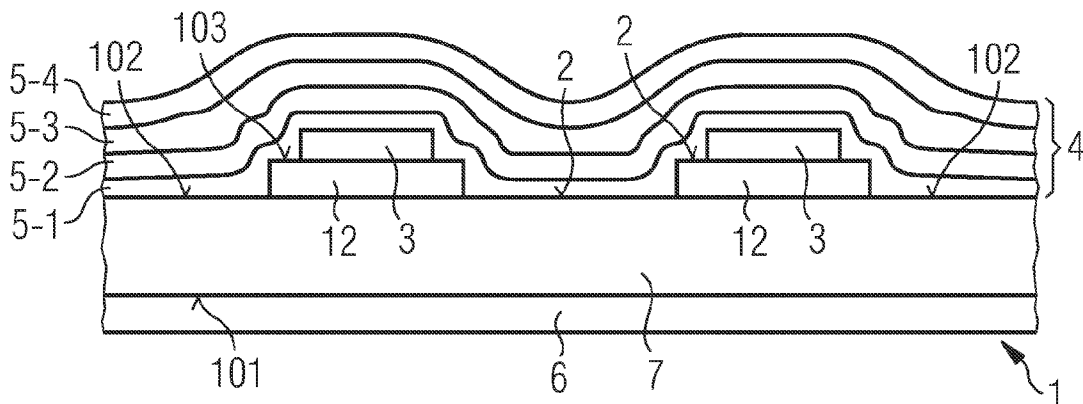
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP,
KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ARRANGEMENT FOR HERMETICALLY SEALING COMPONENTS, AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR HERMETISCHEN ABDICHTUNG VON BAUELEMENTEN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG



(57) Abstract: Disclosed is a method for producing a package. According to said method, a substrate is provided, on a surface of which one or several components are disposed, and a hermetically sealing protective layer is formed on the one or several components and on the surface of the substrate. The hermetically sealing protective layer is impermeable to gas, liquid, and electromagnetic waves, temperature-resistant, electrically insulating, and process-resistant.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung eines Packages umfassend. Das Verfahren beinhaltet das Bereitstellen eines Substrats, wobei auf einer Oberfläche des Substrats ein oder mehrere Bauelemente angeordnet sind, das Ausbilden einer hermetisch abdichtenden Schutzschicht auf dem ein oder den mehreren Bauelementen und auf der Oberfläche des Substrats, wobei die hermetisch abdichtende Schutzschicht die folgenden Eigenschaften aufweist: gasundurchlässig, flüssigkeitsundurchlässig, undurchlässig für elektromagnetische Wellen, temperaturbeständig, elektrisch isolierend und prozessbeständig.

WO 2007/017404 A2



Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Anordnung zur hermetischen Abdichtung von Bauelementen und Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung betrifft ein hermetisch abgedichtetes Package und ein Verfahren zur Herstellung eines hermetisch abgedichteten Packages gemäß den Patentansprüchen 1 und 27.

Eingekapselte Bauelemente können durch mechanische Einwirkung und Umwelteinflüsse geschädigt und außer Funktion gesetzt werden. Zu den Umwelteinflüssen zählen unter anderem Schadgase, wie etwa Sauerstoff, Flüssigkeiten wie etwa Wasser, organische und anorganische Säuren oder elektromagnetische Felder. Die Schadstoffe entfalten insbesondere unter dem Einfluss erhöhter Temperaturen ihre schädliche Wirkung durch Zerstörung von Packagingmaterialien wie etwa Moldingmassen, Epoxiden oder Polyimiden, oder der Bauteile selbst. Die erhöhte Temperatur unterstützt den Diffusionsprozess der Schadstoffe durch das Packagematerial oder entlang Grenzflächen des Packagematerials. Sofern das Bauelement nicht durch ein Metallgehäuse geschützt ist, können elektromagnetische Felder ungehindert zu dem Bauelement vordringen und es schädigen. Typische Packages umfassen Kunststoffabdichtungen, die das Bauteil jedoch nicht hermetisch vor Umwelteinflüssen schützen.

Hermetisch abdichtende Packages zum Schutz vor Umwelteinflüssen umfassen insbesondere Metall- oder Keramikgehäuse. Konventionelle hermetisch abdichtende Gehäuse bestehen aus einem Gehäuseboden und einem Deckel oder einer Kappe. Durch Aufschweißen oder Auflöten des Deckels auf den Gehäuseboden wird das Gehäuse hermetisch abgedichtet. Der Gehäuseboden und der Deckel können große Teile der Fläche einer Leiterplatte oder eines Moduls, auf das das Bauteil montiert ist, beanspruchen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte hermetische Abdichtung eines Bauelements zu schaffen.

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind durch die unabhängigen Patentansprüche angegeben.

Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt ein Verfahren zur Herstellung eines Packages bereit. Das Verfahren beinhaltet das Bereitstellen eines Substrats, wobei auf einer oberen Oberfläche des Substrats ein oder mehrere Bauelemente angeordnet sind. Das Verfahren beinhaltet ferner das Ausbilden einer hermetisch abdichtenden Schutzschicht auf dem ein oder den mehreren Bauelementen und auf der oberen Oberfläche des Substrats, wobei die hermetisch abdichtende Schutzschicht die folgenden Eigenschaften aufweist: gasundurchlässig, flüssigkeitsundurchlässig, undurchlässig für elektromagnetische Wellen, temperaturbeständig, elektrisch isolierend und prozessbeständig.

Bei einer Ausführungsform umfasst das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten. Dies hat den Vorteil, dass Teilschichten mit unterschiedlicher Funktionalität ausgebildet werden können.

Vorteilhaft umfasst das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten das Auflaminieren einer Folie aus elektrisch isolierendem Kunststoffmaterial, wobei vorzugsweise eine Folie aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polyamid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyetheretherketon- und/oder auf Epoxidbasis verwendet wird.

Vorteilhaft umfasst das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten das Ausbilden einer ein Metall aufweisenden metallischen Teilschicht, wobei die ein Metall aufweisende Teilschicht das eine oder die mehreren Bauteile vor elektromagnetischer Strahlung schützt. Das Metall wird bevor-

zugt aus einer Gruppe bestehend aus Aluminium, Kupfer, Titan, und Nickel gewählt.

Bei einer Ausführungsform umfasst das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten das Ausbilden einer ein anorganisches Material aufweisenden anorganischen Teilschicht. Das anorganische Material beinhaltet bevorzugt Siliziumoxid.

Bei einer Ausführungsform umfasst das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten das Ausbilden einer ein organisches Material aufweisenden organischen Teilschicht. Bevorzugt enthält das organische Material Parylene.

Bei einer Ausführungsform umfasst das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht das Ausbilden einer ein Füllmaterial aufweisenden hermetisch abdichtenden Schutzschicht. Das Füllmaterial enthält bevorzugt Siliziumoxid oder Kohlenstoff.

Bei einer Ausführungsform umfasst das Bereitstellen eines Substrats das Bereitstellen eines Substrats, das aus einer isolierenden Schicht, einer auf einer unteren Oberfläche der isolierenden Schicht aufgebrachten ersten Metallschicht und einer auf einer von der unteren Oberfläche abgekehrten Oberfläche der isolierenden Schicht aufgebrachten zweiten, strukturierten Metallschicht besteht.

Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht kann ein physikalisches Abscheideverfahren wie etwa einen Sputter-Prozess oder einen Bedampfungsprozess umfassen.

Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht kann auch einen Sprühprozess oder einen Gießprozess umfassen.

Das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht kann ein chemisches Abscheideverfahren wie etwa ein CVD-Verfahren oder ein LPCVD-Verfahren umfassen.

Bei einer Ausführungsform umfasst das Verfahren zu Herstellung eines Packages des Weiteren das Freilegen einer oder mehrerer Kontaktflächen auf der Oberfläche des Substrats und auf Oberflächen des einen oder der mehreren Bauelemente durch Öffnen jeweiliger Fenster in der hermetisch abdichtenden Schutzschicht, und flächiges Kontaktieren jeder freigelegten Kontaktfläche mit einer Kontaktschicht aus elektrisch leitendem Material. Das Öffnen jeweiliger Fenster kann durch einen lithographischen Prozess, Laserablation, ein Ätzverfahren oder ein mechanisches Verfahren erfolgen.

Bei einer Ausführungsform wird eine Kontaktschicht aus mehreren übereinander angeordneten Teilschichten aus unterschiedlichem, elektrisch leitendem Material verwendet wird.

Unter einem weiteren Aspekt stellt die vorliegende Erfindung ein Package bereit, wobei das Package ein Substrat umfasst, auf einer Oberfläche des Substrats ein oder mehrere Bauelemente ausgebildet sind und wobei auf dem ein oder den mehreren Bauelementen und auf der Oberfläche des Substrats eine hermetisch abdichtende Schutzschicht ausgebildet ist, die die folgenden Eigenschaften aufweist: gasundurchlässig, flüssigkeitsundurchlässig, undurchlässig für elektromagnetische Wellen, temperaturbeständig, elektrisch isolierend und prozessbeständig.

Bevorzugt umfasst die hermetisch abdichtende Schutzschicht mehrere übereinander angeordnete Teilschichten.

Bei einer Ausführungsform ist eine der mehreren Teilschichten aus einer Folie aus elektrisch isolierendem Kunststoff ausgebildet. Die Folie ist bevorzugt aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polyamid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyetheretherketon- und/oder auf Epoxidbasis ausgebildet.

Bei einer Ausführungsform ist eine der mehreren Teilschichten eine ein Metall aufweisende metallische Schicht. Das Metall

wird bevorzugt aus einer Gruppe bestehend aus Aluminium, Kupfer, Titan und Nickel gewählt.

Bei einer Ausführungsform ist eine der mehreren Teilschichten eine ein anorganisches Material aufweisende anorganische Schicht. Das anorganische Material umfasst bevorzugt Siliziumoxid.

Bei einer Ausführungsform ist eine der mehreren Teilschichten eine eine organisch modifizierte Keramik aufweisende Schicht.

Bei einer Ausführungsform ist eine der mehreren Teilschichten eine ein organisches Material aufweisende organische Schicht, wobei das anorganische Material bevorzugt Parylene ist.

Bei einer Ausführungsform enthält die hermetisch abdichtende Schutzschicht ein Füllmaterial. Das Füllmaterial enthält vorwiegend Siliziumoxid oder Kohlenstoff.

Bei einer Ausführungsform besteht das Substrat aus einer isolierenden Schicht, einer auf eine untere Oberfläche der isolierenden Schicht aufgebrachten ersten Metallschicht und einer auf einer von der unteren Oberfläche abgekehrten Oberfläche der isolierenden Schicht aufgebrachten zweiten, strukturierten Metallschicht.

Bei einer Ausführungsform sind Kontaktflächen auf der Oberfläche des Substrats und auf Oberflächen des einen oder der mehreren Bauelemente angeordnet. Die hermetisch abdichtende Schutzschicht weist bei jeder Kontaktfläche ein Fenster auf, in welchem diese Kontaktfläche frei von der hermetisch abdichtenden Schutzschicht und flächig mit einer Kontaktschicht aus elektrisch leitfähigem Material kontaktiert ist. Die Kontaktschicht kann mehrere übereinander angeordnete Einzelschichten aus unterschiedlichem, elektrisch leitfähigem Material umfassen.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung:

Figur 1 zeigt einen Querschnitt eines Packages gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines Packages in einer Stufe des Herstellungsprozesses gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt eines Packages gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

Figur 1 zeigt einen Querschnitt eines Packages gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Auf einem Substrat 1 sind auf einer oberen Oberfläche 2 des Substrats 1 Bauelemente 3 angeordnet. Das Substrat 1 weist beispielsweise ein DCB-Substrat auf, das aus einer isolierenden Schicht 7, bevorzugt aus einem Keramikmaterial, einer auf einer unteren Oberfläche 101 der isolierenden Schicht 7 aufgetragenen ersten metallischen Schicht 6, bevorzugt aus Kupfer und einer auf einer von der unteren Oberfläche 101 abgekehrten oberen Oberfläche 102 der isolierenden Schicht 7 aufgetragenen zweiten metallischen Schicht 12, bevorzugt aus Kupfer besteht.

Die zweite metallische Schicht 12 auf der oberen Oberfläche 102 der isolierenden Schicht 7 ist bereichsweise bis auf die obere Oberfläche 102 herab entfernt. Auf der von der ersten metallischen Schicht 6 abgekehrten Oberfläche 103 der zweiten metallischen Schicht 12 sind Bauelemente 3 angeordnet.

Die generell mit 2 bezeichnete gesamte obere Oberfläche des mit den Bauelementen 3 bestückten Substrats 1 ist durch die freiliegenden Teile der oberen Oberfläche 102 der isolierenden Schicht 7 und der oberen Oberfläche 103 der zweiten metallischen Schicht 12 gegeben.

Die Bauelemente 3 können zueinander gleich oder aber auch voneinander verschieden sein. Beispielsweise sind die Bauelemente Leistungshalbleiterchips. Auf den Bauelementen 3 ist eine hermetisch abdichtende Schicht 4 angeordnet, die eng an Oberflächen und Seitenflächen der Bauelemente 3 anliegt. Die hermetisch abdichtende Schicht 4 ist ferner auf zwischen den Bauelementen 3 befindlichen Bereichen der oberen Oberfläche 2 des Substrats 1 angeordnet und liegt eng an der oberen Oberfläche 2 des Substrats 1 an. Die hermetisch abdichtende Schicht 4 dichtet jedes einzelne Bauelement 3 hermetisch gegenüber Umwelteinflüssen ab. Die hermetische Schutzschicht 4 ist insbesondere gasundurchlässig, flüssigkeitsundurchlässig, undurchlässig für elektromagnetische Wellen, temperaturbeständig, elektrisch isolierend und prozessbeständig. In einer Ausführungsform der Erfindung ist die hermetische Schutzschicht 4 temperaturbeständig gegenüber dem dauerhaften Einfluss von Temperaturen bis 150°C. In einer anderen Ausführungsform ist die hermetische Schutzschicht 4 temperaturbeständig gegenüber dem dauerhaften Einfluss von Temperaturen bis 200°C. Bevorzugt ist die hermetische Schutzschicht 4 gegenüber dem Einfluss von Säuren, Basen und Lösungsmitteln prozessbeständig.

Die hermetisch abdichtende Schicht 4 kann anorganische Materialien, organische Materialien, Metalle, Polymere oder organisch modifizierte Keramiken enthalten. Die hermetisch abdichtende Schicht 4 kann aber auch andere geeignete Materialien enthalten, die vor Umwelteinflüssen schützen. Als Metalle eignen sich besonders Aluminium, Kupfer, Titan oder Nickel. Die Metalle können beispielsweise durch ein Sputter-Verfahren oder durch ein Aufdampf-Verfahren aufgetragen werden. Als Polymere eignen sich insbesondere Duroplast-Polymere oder Thermoplast-Polymere.

Die hermetisch abdichtende Schutzschicht 4 kann ferner ein oder mehrere Füllmaterialien enthalten. Durch die Wahl des Füllmaterials und durch die Variation des Füllmaterialanteils an der hermetisch abdichtenden Schutzschicht 4 kann beispiels-

weise der Wärmeausdehnungskoeffizient der hermetisch abdichtenden Schutzschicht 4 an den Wärmeausdehnungskoeffizienten des Substrats 1 oder der Bauelemente 3 angepasst werden. Dadurch können thermische Spannungen, die infolge von Temperatureinflüssen auftreten, reduziert werden. Thermische Spannungen können zu Rissen bzw. Beschädigung der hermetisch abdichtenden Schutzschicht 4 führen, oder aber die Haftung der hermetisch abdichtenden Schutzschicht 4 auf den Bauelementen 3 und dem Substrat 1 verringern.

Die hermetisch abdichtende Schutzschicht 4 kann mehrere übereinander angeordnete Teilschichten 5 umfassen. Die einzelnen Teilschichten 5 weisen bevorzugt unterschiedliche Funktionswerkstoffe auf. Beispielsweise ist eine erste Teilschicht 5-1 elektrisch isolierend, eine zweite Teilschicht 5-2 undurchlässig für elektromagnetische Wellen, eine dritte Teilschicht 5-3 flüssigkeitsundurchlässig und gasundurchlässig. Eine vierte Teilschicht 5-4 schützt die Bauelemente 3 vor mechanischer Beschädigung.

In einer Ausführungsform beinhaltet eine erste Teilschicht 5-1 eine unter Vakuum auflaminierte Folie bestehend aus elektrisch isolierendem Kunststoffmaterial. Die Folie kann zur Verbesserung der Haftung auf der oberen Oberfläche 2 des Substrats 1 und auf den Bauelementen 3 eine Klebebeschichtung aufweisen. Die Dicke der Folie kann 25 bis 500 μm betragen.

Eine zweite Teilschicht 5-2 ist als eine Metallschicht ausgebildet. Die Metallschicht ist eng anliegend auf ersten Teilschicht 5-1 aufgebracht und weist eine ausreichende Dicke auf, um die Bauelemente 3 vor elektromagnetischen Wellen zu schützen. Die Metallschicht umfasst bevorzugt Aluminium, Kupfer, Titan oder Nickel. Die Metallschicht kann durch einen Sputter-Prozess oder einen Aufdampfprozess auf die auflaminierte Folie aufgebracht werden.

Eine dritte Teilschicht 5-3 ist als eine organische Schicht ausgebildet und umfasst bevorzugt Parylene. Die organische Schicht ist eng anliegend auf der zweiten Teilschicht 5-2 aufgebracht und weist eine ausreichende Dicke auf, um die Bauelemente 3 und die darunter angeordneten Teilschichten 5-1 und 5-2 vor Flüssigkeiten und Gasen zu schützen.

Eine vierte Teilschicht 5-4, die bevorzugt eine Package-Schicht ist, umfasst bevorzugt Kunstharz oder ein anderes geeignetes Moldingmaterial. Die vierte Teilschicht 5-4 schützt die Bauelemente 3 vor mechanischer Beschädigung.

Die Reihenfolge und die Anzahl der übereinander angeordneten Teilschichten 5 kann auch variieren. Beispielsweise kann die zweite Teilschicht 5-2 als organische Schicht, und die dritte Teilschicht 5-3 als Metallschicht ausgebildet sein.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines Packages in einem Stadium des Herstellungsprozesses gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Kontaktflächen 8 auf Oberflächen der Bauelemente 3 und auf der oberen Oberfläche 2 des Substrats 1 sind durch Öffnen von Fenstern 9 in der hermetisch abdichtenden Schicht 4 freigelegt. Die Fenster 9 werden durch einen Strukturierungsprozess geöffnet. In einer Ausführungsform wird die hermetisch abdichtende Schicht 4 im Bereich der Kontaktflächen 8 mittels Laserablation abgetragen. Aber auch andere Varianten der Strukturierung der hermetisch abdichtenden Schicht 4 sind denkbar. Beispielsweise kann die hermetisch abdichtende Schicht 4 mittels eines Plasmaätzverfahrens strukturiert werden. Das Strukturieren kann aber auch durch einen fotolithographischen Prozess erfolgen. Dazu kann auf der hermetisch abdichtenden Schicht 4 ein Fotolack aufgetragen werden, getrocknet und anschließend belichtet werden. Als Fotolack kommen herkömmliche positive oder negative Resists (Beschichtungsmaterialien) in Frage. Der Fotolack kann beispielsweise durch einen Sprüh- oder Tauchprozess aufgetragen werden. Aber auch Electro-Deposition zur Aufbringung des Fotolacks ist denkbar.

Einzelne Teilschichten 5 der hermetisch abdichtenden Schicht 4 können durch unterschiedliche Strukturierungsprozesse strukturiert werden. Beispielsweise kann eine als metallische Schicht ausgebildete Teilschicht 5 mittels eines Plasmaätzverfahrens strukturiert werden, und eine aus elektrisch isolierendem Kunststoffmaterial ausgebildete Teilschicht 5 mittels eines fotolithographischen Prozesses strukturiert werden.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt des in Figur 2 dargestellten Packages nach Aufbringung einer strukturierten Kontaktschicht 10 aus elektrisch leitfähigem Material 10, vorzugsweise ein Metall, auf die freigelegten Kontaktflächen 8. Das Aufbringen des elektrisch leitfähigen Materials 10 auf die freigelegten Kontaktflächen 8 kann das Aufbringen einer Maske auf die hermetisch abdichtende Schicht 4 beinhalten, die die Kontaktflächen 8 freilässt. Dann wird das elektrisch leitfähige Material ganzflächig auf die hermetisch abdichtende Schicht 4 und auf die freigelegten Kontaktflächen 8 aufgebracht. Danach wird die Maske mit der darauf befindlichen Kontaktschicht 10 entfernt, so dass nur die flächig kontaktierten Kontaktflächen 8 auf den maskenfreien Bereichen übrig bleiben. Die Kontaktschicht 10 kann auch mehrere übereinander angeordnete Einzelschichten 11-1, 11-2 aus unterschiedlichem elektrisch leitfähigem Material umfassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Packages umfassend:

Bereitstellen eines Substrats (1), wobei auf einer oberen Oberfläche (2) des Substrats (1) ein oder mehrere Bauelemente (3) angeordnet sind;

Ausbilden einer hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) auf dem ein oder den mehreren Bauelementen (3) und auf der oberen Oberfläche (2) des Substrats (1), wobei die hermetisch abdichtende Schutzschicht (4) die folgenden Eigenschaften aufweist: gasundurchlässig, flüssigkeitsundurchlässig, undurchlässig für elektromagnetische Wellen, temperaturbeständig, elektrisch isolierend und prozessbeständig.

2. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 1, wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten (5) umfasst.

3. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 2, wobei das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten (5) das Auflaminieren einer Folie aus elektrisch isolierendem Kunststoffmaterial umfasst.

4. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 3, wobei eine Folie aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polyamid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyetheretherketon- und/oder auf Epoxidbasis verwendet wird.

5. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der Patentansprüche 2 bis 4, wobei das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer ein Metall aufweisenden metallischen Teilschicht (5) umfasst.

6. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 5, wobei das Metall aus einer Gruppe bestehend aus Aluminium, Kupfer, Titan, und Nickel gewählt ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der Patentansprüche 2 bis 6, wobei das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer ein anorganisches Material aufweisenden anorganischen Schicht umfasst.

8. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 7, wobei das anorganische Material Siliziumoxid enthält.

9. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der Patentansprüche 2 bis 8, wobei das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer ein organisches Material aufweisenden organischen Schicht umfasst.

10. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 9, wobei das organische Material Parylene enthält.

11. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der Patentansprüche 2 bis 10, wobei das Ausbilden mehrerer übereinander angeordneter Teilschichten (5) das Ausbilden einer eine organisch modifizierte Keramik aufweisende Schicht umfasst.

12. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der Patentansprüche 2 bis 10, wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) das Ausbilden einer ein Füllmaterial aufweisenden hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) umfasst.

13. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 12, wobei das Füllmaterial Siliziumoxid oder Kohlenstoff enthält.

14. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei das Bereitstellen eines Substrats das Bereitstellen eines Substrats umfasst, das aus einer isolierenden Schicht (7), einer auf einer unteren Oberfläche (101) der isolierenden Schicht (7) aufgebrachten ersten Metallschicht (6) und einer auf einer von der unteren Oberfläche (101) abgekehrten Oberfläche (102) der isolierenden Schicht (7) aufgebrachten zweiten, strukturierten Metallschicht (12) besteht.

15. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) ein physikalisches Abscheideverfahren umfasst.

16. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 14, wobei das physikalische Abscheideverfahren einen Sputter-Prozess oder einen Bedampfungsprozess umfasst.

17. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) einen Sprühprozess umfasst.

18. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) einen Gießprozess umfasst.

19. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei das Ausbilden der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) ein chemisches Abscheideverfahren umfasst.

20. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß Patentanspruch 19, wobei das chemische Abscheideverfahren ein CVD-Verfahren oder ein LPCVD-Verfahren umfasst.

21. Verfahren zur Herstellung eines Packages gemäß einem der vorhergehenden Patentansprüche, des Weiteren umfassend:
Freilegen einer oder mehrerer Kontaktflächen (8) auf der Oberfläche (2) des Substrats (1) und auf Oberflächen des einen oder der mehreren Bauelemente (3) durch Öffnen jeweiliger Fenster (9) in der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4), und flächiges Kontaktieren jeder freigelegten Kontaktfläche (8) mit einer Kontaktschicht (10) aus elektrisch leitendem Material.

22. Verfahren nach Patentanspruch 21, wobei das Öffnen jeweiliger Fenster (9) einen fotolithographischen Prozess umfasst.

23. Verfahren nach Patentanspruch 21 oder 22, wobei das Öffnen jeweiliger Fenster (9) Laserablation umfasst.

24. Verfahren nach Patentansprüchen 21 bis 23, wobei das Öffnen jeweiliger Fenster (9) ein Ätzverfahren umfasst.

25. Verfahren nach Patentansprüchen 21 bis 24, wobei das Öffnen jeweiliger Fenster (9) ein mechanisches Verfahren umfasst.

26. Verfahren nach Patentansprüchen 21 bis 25, wobei eine Kontaktschicht (10) aus mehreren übereinander angeordneten Einzelschichten (11) aus unterschiedlichem, elektrisch leitendem Material verwendet wird.

27. Ein Package, umfassend:
ein Substrat (1), wobei auf einer Oberfläche (2) des Substrats (1) ein oder mehrere Bauelemente (3) ausgebildet sind;
wobei auf dem ein oder den mehreren Bauelementen (3) und auf der Oberfläche (2) des Substrats (1) eine hermetisch abdich-

tende Schutzschicht ausgebildet ist, die die folgenden Eigenschaften aufweist:

gasundurchlässig, flüssigkeitsundurchlässig, undurchlässig für elektromagnetische Wellen, temperaturbeständig, elektrisch isolierend und prozessbeständig.

28. Package gemäß Patentanspruch 27, wobei die hermetisch abdichtende Schutzschicht (4) mehrere übereinander angeordnete Teilschichten (5) umfasst.

29. Package gemäß Patentanspruch 28, wobei eine der mehreren Teilschichten (5) eine Folie aus elektrisch isolierendem Kunststoff ist.

30. Package gemäß Patentanspruch 29, wobei die Folie aus einem Kunststoffmaterial auf Polyimid-, Polyamid-, Polyethylen-, Polyphenol-, Polyetheretherketon- und/oder auf Epoxidbasis ausgebildet ist.

31. Package gemäß einem der Patentansprüche 28 bis 30, wobei eine der mehreren Teilschichten (5) eine ein Metall aufweisende metallische Schicht ist.

32. Package gemäß Patentanspruch 31, wobei das Metall aus einer Gruppe bestehend aus Aluminium, Kupfer, Titan und Nickel gewählt ist.

33. Package gemäß einem der Patentansprüche 28 bis 32, wobei eine der mehreren Teilschichten (5) eine ein anorganisches Material aufweisende anorganische Schicht ist.

34. Package gemäß Patentanspruch 33, wobei das anorganische Material Siliziumoxid enthält.

35. Package gemäß einem der Patentansprüche 28 bis 34, wobei eine der mehreren Teilschichten (5) eine ein organisches Material aufweisende organische Schicht ist.

36. Package gemäß Patentanspruch 35, wobei das anorganische Material Parylene enthält.

37. Package gemäß einem der Patentansprüche 28 bis 36, wobei eine der mehreren Teilschichten (5) eine organische modifizierte Keramik aufweisende Schicht ist.

38. Package gemäß einem der Patentansprüche 27 bis 37, wobei die hermetisch abdichtende Schicht (4) ein Füllmaterial aufweist.

39. Package gemäß Patentanspruch 38, wobei das Füllmaterial Siliziumoxid oder Kohlenstoff enthält.

40. Package gemäß einem der Patentansprüche 27 bis 39, wobei das Substrat (1) aus einer isolierenden Schicht (7), einer auf einer unteren Oberfläche (101) der isolierenden Schicht (7) aufgetragenen ersten Metallschicht (6) und einer auf einer von der unteren Oberfläche (101) abgekehrten Oberfläche (102) der isolierenden Schicht (7) aufgetragenen zweiten, strukturierten Metallschicht (12) besteht.

41. Package gemäß einem der Patentansprüche 27 bis 40, wobei Kontaktflächen (8) auf der Oberfläche des Substrats (1) und auf Oberflächen des einen oder der mehreren Bauelemente (3) angeordnet sind, und die hermetisch abdichtende Schutzschicht (4) bei jeder Kontaktfläche (8) ein Fenster (9) aufweist, in welchem diese Kontaktfläche (8) frei von der hermetisch abdichtenden Schutzschicht (4) und flächig mit einer Kontaktschicht (10) aus elektrisch leitfähigem Material kontaktiert ist.

42. Package gemäß Patentanspruch 41, wobei die Kontaktschicht (10) mehrere übereinander angeordnete Einzelschichten (11) aus unterschiedlichem, elektrisch leitfähigem Material umfasst.

FIG 1

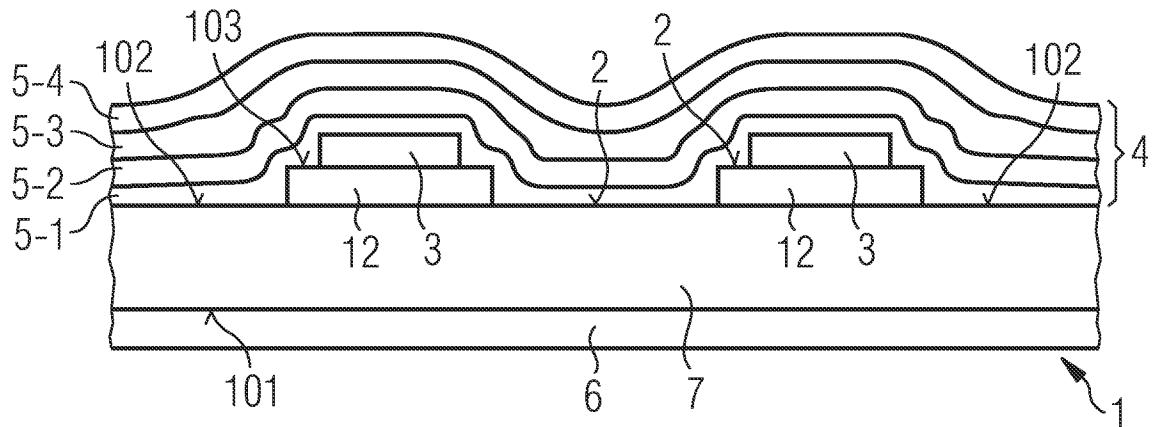


FIG 2

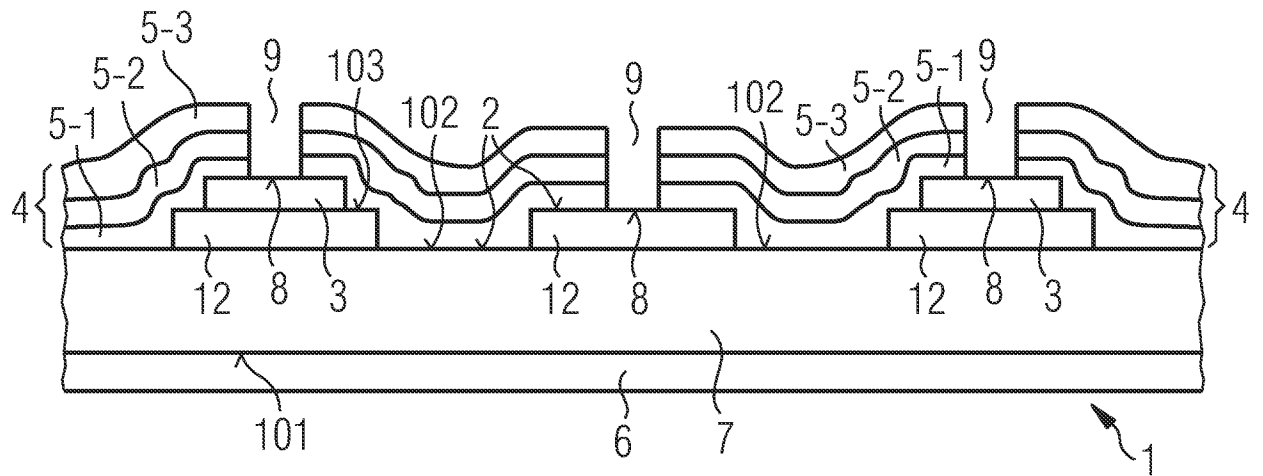


FIG 3

